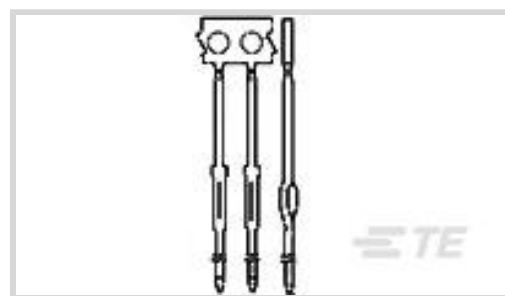




连接器 > 端子 > 连接器端子



端子类型: 插针

端子接触部电镀材料: 金

端子基材: 铜合金

产品端接到: 印刷电路板

端子额定电流 (最大值) : 3 A

## 产品特性

### 电气特征

绝缘电阻	2000 MΩ
接触电阻	8 mΩ

### 接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1.27 μm[49.9999 μin]
端子接合区域电镀材料厚度	1.27 μm[50 μin]
端子方向	直式
PCB 端子端接区域电镀材料	金
端子类型	插针
端子接触部电镀材料	金
端子基材	铜合金
端子额定电流 (最大值)	3 A

### 端接特性

端接柱体和尾部长度的	17.45 mm[.687 in]
PCB 端接方法	通孔 - 免焊连接
产品端接到	印刷电路板

### 机械附件

带导线绝缘	不带
PCB 安装固定	带有
PCB 安装固定类型	作用/符合标准的尾

## 尺寸

PCB 厚度 (建议)	2.36 – 3.18 mm [.093 – .125 in]
-------------	---------------------------------

## 使用环境

工作温度范围	-65 – 125 °C [-85 – 257 °F]
--------	-----------------------------

## 操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

## 包装特性

封装数量	50000
封装方法	Reel

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



## 该系列中的其他产品 | AMP ECONOMATE



## 客户还购买了



## 文档

### 产品图纸

POST F-THRU 100 C/L PLATED

英文版本

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_117249-2\\_BV.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_117249-2\\_BV.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_117249-2\\_BV.3d\\_stp.zip](#)



英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**产品规格**

Terminating AMP MTEI Connector

英文版本

**应用规格**

英文版本